

精密実験室プレス用10T真空自動ホットプレス

商品番号: XP32



前書き

200x200mm加熱プレス板と高速真空ポンプを備えた高精度卓上型10T真空自動ホットプレス。ポリマー硬化、バッテリー電極接合、材料研究に最適。均一な加熱と精密な圧力制御を必要とする実験室環境に理想的で、プログラマブルタッチスクリーン付きCE認証取得。

[詳細を学ぶ](#)

用途	説明	主な利点
ポリマーフィルム積層	熱と真空下でポリマーシートまたはフィルムを積層し、多層構造を作成。	均一な圧力と温度により反りやポイドを防止。
バッテリー電極接合	リチウムイオンまたは全固体電池用に電極材料を集電体に接合。	不活性ガスパージにより酸化を防止し、高い導電性を確保。
粉末圧粉 (ダイ使用)	より小さなダイを使用して金属、セラミック、または複合材料粉末を高密度ペレットに圧粉。	φ50 mmダイで最大50.9 MPaの高圧達成可能。
薄膜処理	電子機器およびセンサー用途向けの薄膜の硬化およびアニーリング。	真空環境下で300°Cまでの精密な温度制御。
セラミック焼結	熱と圧力を組み合わせた条件下でのセラミック生体の初期段階焼結。	気孔率の低減と機械的特性の向上。
複合材料硬化	炭素繊維またはガラス繊維複合材料プリプレグの硬化。	均一な圧力分布により積層品質を確保。
有機エレクトロニクス封止	不活性雰囲気下での敏感な有機エレクトロニクスデバイスの封止。	無酸素環境によりデバイス寿命を延長。

パラメータ	仕様	備考
モデル	XP32	自動加熱真空プレス
最大作動圧力	≤ 10 トン (100 kN)	プログラマブルシステムによる制御
圧力精度	± 0.1 トン (1 kN)	高精度荷重フィードバック
プレス板作動温度	室温 (RT) - 300 °C	プログラマブルPIDタッチスクリーン
加熱電力	3500 W	高密度ヒータ素子アレイ
プレス板寸法	200 mm × 200 mm	研削平プレス板
プレス板開口 (デイト)	50 mm	高速真空サイクルのためのコンパクトな開口部
付属真空ポンプ	ロータリーベーンメカニカルポンプ	標準付属品
真空ポンプ排気速度	240 L/min (8.5 CFM)	高速排気能力
到達真空度	<-0.1 MPa	相対ゲージ圧
作動雰囲気	窒素 (N ₂) / アルゴン (Ar)	真空・パージ互換
電源	AC 208V / 60Hz (単相)	米国施設向け最適化

パラメータ	仕様	備考
認証	CE 認証取得	標準安全規格適合

オプション	標準コントローラー (付属)	高度産業用PLCアップグレード (オプション)
インターフェース	7インチカラータッチスクリーン	高解像度タッチスクリーン付きシーメンス産業用PLC
コア機能	基本PID温度プロファイリング、目標圧力入力、自動保持、自動時間減圧	複雑なマルチステップ温度/圧力プロファイリング、レシピ保存 (最大99プロファイル)、精密ロードセルフフィードバック、イーサネットデータロギング
最適用途	標準積層、ポリマー硬化、簡易ペレット圧粉	学術研究、ASTM試験規格、精密なステップバイステップ圧力補償を必要とするプロセス